

Title (en)

Method and device for applying fluid to pasty substances on surfaces.

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum Aufbringen von flüssigem bis pastösem Material auf Oberflächen.

Title (fr)

Procédé et dispositif pour appliquer des matériaux liquides à pâteuses sur des surfaces.

Publication

**EP 0534148 A1 19930331 (DE)**

Application

**EP 92114440 A 19920825**

Priority

- DE 4132040 A 19910926
- DE 4141252 A 19911214

Abstract (en)

The invention relates to a method and a device (1) for applying material in gaps or depressions on, or in, surfaces. In this arrangement, the invention proposes to suck the material out of a material container (8) through these gaps with the aid of an exterior subatmospheric pressure. The corresponding device (1) exhibits a subatmospheric-pressure chamber (7) and a material container (8), these two chambers adjoining each other and exhibiting openings directed towards the surface to be treated.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung (1) zum Aufbringen von Material in Lücken oder Vertiefungen auf bzw. in Oberflächen. Dabei schlägt die Erfindung vor, das Material aus einem Materialbehälter (8) durch diese Lücken mit Hilfe von einem äußeren Unterdruck anzusaugen. Die entsprechende Vorrichtung (1) weist eine Unterdruckkammer (7) und einen Materialbehälter (8) auf, wobei diese beiden Kammern aneinander anschließen und zur zu behandelnden Oberfläche gerichtete Öffnungen aufweisen.

IPC 1-7

**A47L 11/20; E04F 21/16**

IPC 8 full level

**B05D 1/32** (2006.01); **A47L 11/20** (2006.01); **B05C 5/02** (2006.01); **E01C 23/09** (2006.01); **E04B 1/68** (2006.01); **E04F 15/14** (2006.01);  
**E04F 21/16** (2006.01); **E04F 21/165** (2006.01)

CPC (source: EP)

**A47L 11/20** (2013.01); **A47L 11/4083** (2013.01); **E01C 23/0973** (2013.01); **E04F 21/165** (2013.01)

Citation (search report)

- [Y] AU 507426 B2 19800214 - BALFOUR BEATTY LTD
- [Y] US 4781556 A 19881101 - PAUL JESSE D [US]
- [A] US 4856138 A 19890815 - INGERMANN DONALD E [US], et al
- [A] US 2226466 A 19401224 - WILLIAM HELTZEL JOSEPH
- [A] FR 2412658 A1 19790720 - HAYAT ROGER [FR]
- [AD] DE 3622055 A1 19870619 - MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [JP]

Cited by

CN111287089A

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI NL PT SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0534148 A1 19930331; EP 0534148 B1 19970416;** AT E151840 T1 19970515; CZ 261492 A3 19930616; DE 4141252 C1 19930311;  
DE 59208351 D1 19970522; PL 296037 A1 19930531; SK 261492 A3 19940202

DOCDB simple family (application)

**EP 92114440 A 19920825;** AT 92114440 T 19920825; CS 261492 A 19920825; DE 4141252 A 19911214; DE 59208351 T 19920825;  
PL 29603792 A 19920924; SK 261492 A 19920825